1	Sys	Sede	Capitolo C	ateg WBS	Descrizione	Richiesta	Richies SJ	Anticipa 2011 ?	Commenti	Descriper DB
1	e)/T	DI	CONSTINO		generazione) alta velocita' (150MHz) con traslatori					SVT-A testhood multicourses (ship sind quain appearation) allo usleditr' (#ENNIA) are treated to UVIS per testhoom
1.	SVT	PI	CONSUMO A		carriers INMAPS I sottomissione	1	1			SVT:A:carriers INMAPS I sottomissione
1	SVT	PI	CONSUMO A		carriers Superpix1 con sensore bump-bondato	1	1			SVT-Acarriers INMAP'S sottomissione SVT-Acarriers Superpix to on sensore bump-bondato
March Company Compan	SVT	PI	CONSUMO A		per strip		5			SVT-A testboard (3KE) e carriers (2KE) 2 prototipl FE chip per strip
1	SVI	PI	CONSUMO		bump-bonding FE pixel chip Superpix1 spessore	//	,			SV1/A:Sottomissione International Internatio
1.	SVT	PI	CONSUMO A		assembly IZM)	20)			SVT:A:bump-bonding FE pixel chip Superpix1 spessore 100 um con sensori (6.5 kE ROC wafer + 13.5 kE assembly IZM)
1	CVCT	DI	CONCLINO		bump-bonding FE pixel chip Superpix1 spessore standard con sensori (6.5 kE ROC wafer + 13.5 kE	~				AND
1					meccanica integrazione costi per realizzazione	20				
Management Man					meccanica integrazione costi per realizzazione arco					
1	SVI	PI	CONSUMO A		materiale per instrumentazione moduli prototipi e	- 4	1			SVI-A-meccanical integrazione costi per realizzazione arco con nuovo designi LUK
March Marc	SVT	PI	CONSUMO A		termocoppie)		5			SVT:A:materiale per instrumentazione moduli prototipi e test termostrutturali lab TFD (riscaldatori, termocoppie)
See Developed Company of the Company					supporto/cooling modulo a pixel (microtubi in fibra					
Company	SVT	PI	CONSUMO A		kE)		5			SVT:A:meccanica materiale per realizzazione prototipi supporto/cooling modulo a pixel (microtubi in fibra di carbonio 3.5kE e interfacce idrauliche relative 1.5kE)
1	SVT	PI	CONSUMO A		con cooling per pixel	2.5	5			SVT:A:consumi lab TFD per test di continuita' su supporti con cooling per pixel
1					70 gr/min (nuovi microcanali con diametro 200 um)	4.5	5			SVT:A:flussimetro a effetto coriolis per range di portata 30-70 gr/min (nuovi microcanali con diametro 200 um)
1	SVT	PI			allestimento testbeam (meccanica + elettronica) Mantenimento clean room		5			
1					Contatti ing mecc.con collaboratori e ditte (Plyform					
1					Novara)	1 2	2			
Part					Test di sistema Beam Test a Bologna	2	4			SVT:A:Test di sistema Beam Test a Bologna
1					Responsabilita' SVT Convener Test beam al CERN	14	1			SVT:C:Responsabilita' SVT Convener
1. Company	SVT	PI			Contatti ing mecc SLAC per sviluppo interaction					
1	SVT	PI	ESTERO A		Contatti ing mecc UK per sviluppo meccanica SVT	2	2			SVT:A:Contatti ing mecc UK per sviluppo meccanica SVT
1					Pulstrusion)					SVT:A:Contattl ing mecc con ditte estere (Van Dijk Pulstrusion) SVT:C:Responsabilitat SVT Convener
1			LICENZE-			1				
1					Wafer di silicio 200um per prototipi meccanici	١				
## 15	SVT	TS	CONSUMO A		Prototipi tails Layer esterni	1	7		UNICI IA	SVT:A:Prototipi talis Layer esterni
1.					Materiale vario per Beam Test	2	2			SVT-A-Materiale vario per Beam Test
1	SVT	TS	CONSUMO A		e vuoto)	1.5	5			SVT.A:Mantenimento Clean Room (prefiltri e impianto gas e vuoto)
1		TS	LICENZE- SW A		(Mentor Graphics)	1.5	5			
1	SVT	TS	SW A		(Synopsys Advanced TCAD)					SVT:A:Manutenzione annuale SW simulazione sensori (Synopsys Advanced TCAD)
1					0.5 keuro Spedizioni per irraggiamenti a Lubiana Coordinamento con gruppo di Milano per fanout e	0.5	5			SVT-A-0.5 keuro Spedizioni per irraggiamenti a Lubiana
1	SVT	TS TS			tails		1	_		SVT-X-Coordinamento con gruppo di Milano per fanout e tails SVT-X-Est di sistema Beam Test a Bologna
19	SVT	TS	ESTERO A				3			
March Marc		TS	ESTERO A		Beam Test CERN	- 6	3			SVT:A:Beam Test CERN
Content		MLR	CONSUMO A		produzione fanout CERN + controllo e correzione	15	,			
March Company Compan					produzione fanout TVR Schio sj a buona risucita					
1985 1980			CONCOMIC		assemblaggio prototipi elettricamente funzionanti					STATE CONTROL OF THE
March September Comment Comm	SVT	MI-B	CONSUMO A		schede di test)		5			SVT:A:assemblaggio prototipi elettricamente funzionanti con sensori e ASIC gla' disponibili (componenti e schede di test)
March Marc	SVT									SVT:A:Cern per fanout
Part	SVT				Sviluppo di fast front-end e slow front-end per					SVT:
March Marc					ner prototino + blocchi ausiliari i e DC-DC					
Fig. Fig.				VBS 1.1.1	Realizzazione di PCB per caratterizzazione di	84	1			
Fig. 1975 A. Incomparison of profession of the company of th					Contatti sviluppi chip e test Pisa	2	2			
Vision V	SVT	PV	ESTERO A		su tecnologia INMAPS (1 mese uomo)		5			SVT:A:Meeting con gruppi di ricerca a RAL e Strasburgo su tecnologia INMAPS (1 mese uomo)
March Marc					Meeting con IC design group del CERN su tecnologia IBM 130 nm (1 mese uomo)					SVT:A:Meeting con IC design group del CERN su tecnologia IBM 130 nm (1 mese uomo)
Mathematical Control	SVT				Test beam al CERN 1 mu	4	1			SVT::
Management Man	SVT	MI	CONSUMO A				5			
Fig. Concept Content					Sottomissione IC encoder prototing per HDI (Silicon					
Fig. Collegation Communication Communi	SVT	MI	CONSUMO A	VBS 1.1.1	4 on Sapphire) fanout Layer0 14kE II iterazione + 2 kE test setup					[SVT-WBS: Sottomissions IC encoder prototipo per HDI (Silicon on Sapphire) SVT-Afnou Layer 01 Alf. El Interzaine + 2 kE fest setup
Management Man						7	7			SVT:A:tails: II iterazione tails "quasi finali" Layer0
Wilson	SVT				consumi laboratorio	2	2			SVT::consumi laboratorio
Visit Visi	SVT	MI	CONSUMO V	VBS 1.1.3	3 planes and fewer layers)	9	9			SVT:WBS:II Iterazione THIN Al pixel bus (thinner Al power planes and fewer layers)
MITTEND A		MI	SW A		alta frequenza	3	3			SVT-A-Microwave Office per la progettazione di circuiti ad atta frequenza SVT-A-Microwave Office per la progettazione di circuiti ad atta frequenza SVT-A-Pattern exercator DE73.
MTRIPRO A Contract on Py per power destination 5 STA Accounts on Py per power destination STA Accounts on Py per power destination STA Accounts on Py per power destination STA Accounts on State STA Accoun	SVT	MI	INTERNO A		Contatti ing ele per sviluppo chip FE con PV/PI/BO					SVT:A:Contatti ing ele per sviluppo chip FE con PV/PI/BO
MTRHY A	SVT	MI	INTERNO A		Contatti con PV per power distribution					SVT:A:Contatti con PV per power distribution
Maintain	SVT	MI	INTERNO A		Contatti con Aurel per HDI	1	1			SVT:A:Contatti con Aurel per HDI
STATE STAT					Contatti CERN per AL bus development & link					SVT.A:Contatti CERN per AL bus development & link
SYTE CONSIGNO A 1.7 Produce custs mark FEB beard 1 SYTE Syt Syte Syt		МІ	ESTERO A			13	3			SVT.A.Contatti con Dallas per sviluppi serializer/driver/receiver + test
Vision V	SVT	во	CONSUMO V	/BS 1.7.1	Prototipo scala reale FEB board					SVT:WBS:Prototipo scala reale FEB board
Europaratice per CAD Cadence, Sympogue e 2 s SYT-Lesson serve per microsetterionia: Secendary per serve per CAD Cadence, Sympogue e Mentor Graphica SYT	SVT	ВО	CONSUMO A		Licenze sw per microelettronica: licenze floating	2	2			SVT-AMetabolismo laboratorio
WILETAND WILETAND Construction of the process	SVT				Europractice per CAD Cadence, Synopsys e Mentor Graphics	2.5	5			SVT::Licenze sw per microelettronica: licenze floating Europractice per CAD Cadence, Synopsys e Mentor Graphics
No.	SVT	BO	TRASPORT		Trasporti per testbeam	2.5	5			[SVT-APC categoria server per DAQ SVT-A.Trasporti per testbeam
SVT BA CONSUMO A INTERNO A MICHAEL AND A MIC	SVT				Contatti Pisa per test prototipi chip pixel/strip	2	2			SVT:A:Contatti Pisa per test prototipi chip pixelistrip SVT:A:Testbeam CERN
SVT A CONSUMO A assortigitate conness on hump-bonding S SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding S SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding S SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding S SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding S SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components per test functional kind pixel assortigitate conness con hump-bonding SVT-Artestoard/components (assortigitate pixel per test pe	SVT					`				
Note					assottigliati connessi con bump-bonding		5			
Vistor V	SVT				MI ele	3	3			
NT NTERN	SVT									SVT:A:Consumi Laboratorio
SVT N					contatti con collaboratori TS/BA design sensori					
SVT To Construct Const					Contatti IZM per bump-bonding		2			SVT:A:Contatti IZM per bump-bonding
No.		то	CONSUMO A			1	1			
SYT TO ESTERO A Participazione testbeam 4 SYT-AParticipazione testbeam SYT-	SVT	TO	INTERNO A		tavolo					SVT-A-Preparazione testbeam a Bologna allestimento tavolo
SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT:	SVT	TO	ESTERO A							SVT:A:Partecipazione testbeam
SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT:										
SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT:										SVT::
SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT:										SVT::
SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT:										SVT::
SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT:										SVT::
SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT: SVT:										SVT::
SV1: SV1: SV1: SV1: SV2: SV2: SV4: SV4: SV4:										SVT::
SVI:: SVI:: SVI:: SVI:: SVI:: SVI::										SVT::
SVT: SVT: SVT: SVT:										SVT::
SVI:: SVI::										SVT::